

Transfer Molding System

Model YPM1200



High productivity transfer molding system for lead frames

高生産性へシフトする リードフレーム専用モデル

製品情報



日本語

- 200tonの高出力プレスにより大判化に対応
- 大容量樹脂に対応できる、デュアルプランジャ&ロングタブレット仕様が選択可能
- 安定生産可能なプランジャ集塵機構を搭載
- リードフレーム生産でニーズの多いオプションを標準化
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
モデル			—	YPM1200			
装置区分			—	シングルプランジャ		デュアルプランジャ	
ワークタイプ			—	リードフレーム			
ワークサイズ		長さ	mm	150—300			
		幅	mm	35—100		35—80	
樹脂		径	mm	φ 13, 14, 16, 18, 20		φ 13, 14, 16, 18	
		長さ	mm	1 pce: 1.1 times the tablet diameter—35.0 2 pcs: 65.0 (Max.)			
マシンタイム			sec	1 pce: Approximately 20 2 pcs: Approximately 40		1 pce: Approximately 40 2 pcs: Approximately 80	
外形寸法	プレス数		module	1	2	3	4
	スタックマガジン仕様	幅	mm	2,560	3,260	3,960	4,660
		奥行き	mm	1,600	1,600	1,600	1,600
		高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
	スリットマガジン仕様	幅	mm	2,560	3,260	3,960	4,660
		奥行き	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
		高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		スタックマガジン仕様	ton	6.1	9.6	13.1	16.6
		スリットマガジン仕様	ton	6.4	9.9	13.4	16.9
成形取り数			workpiece	2	4	6	8
インプットマガジンスペース			mm	550			
アウトプットマガジン数（スタックマガジン仕様）			pcs	2			
アウトプットマガジンスペース（スリットマガジン仕様）			mm	440			
クランプ出力			kN／(tf)	490.0—1,960.0／50.0—200.0			
トランスファ出力			kN／(tf)	3.92—49.0／0.4—5.0（2圧設定）			
品種切替え方式			—	キット交換式			
搭載可能金型			—	L, XL, XXL or デュアルプランジャ専用金型			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation